

現場業務をこの一台に。

堅牢性と信頼性を兼ね備えた高耐久スマホ。



詳細情報は
WEBサイトへ

JM JAPAN
MADE



落下・衝撃に強く、電池交換が可能。過酷な現場で長く使える。



コーナー
バンパー設計

リム構造設計

HYBRID SHIELD®

カメラ部を守る
多面体構造

リアカバー設計

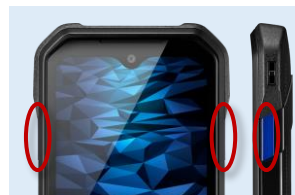


バッテリー交換機能
(ウォームスワップ対応)

・バンパーを搭載した堅牢フォルム。強靱なねじれ剛性を実現する設計、放熱設計など独自の高耐久技術を導入し過酷な現場で活躍。
・ディスプレイにはハイブリッドシールドを採用し、割れにくさを実現。

・電池が劣化しても電池交換が可能なので、本体の長期間利用が可能。
・電源オフすることなく予備電池へ交換可能なウォームスワップ対応。

現場を支える優れた機能と操作性。業務の効率化を実現。



■ダイレクトボタン

押すだけで、事前に設定したアプリが起動するダイレクトボタンを本体側面に2つ搭載。法人業務の効率化が可能です。



■バーコード読取りアプリ

連続読取りや複数同時読取りが可能です。読取り後は端末内に保存したり、別アプリに連携できます。



■sXGP対応

1.9GHz周波数帯を使用した自営通信用TD-LTE規格、sXGP対応。医療機関などでも安心して利用できます。



■グローブタッチ®

軍手や作業用グローブをしたまま操作可能です。作業を止めることなく業務の効率化を実現します。



■ウェットタッチ®

画面や手が濡れた状態でも操作可能です。配達中などの突如の雨でも安心して使用できます。

さまざまな業界・業種で活躍する、現場に最適な高耐久スマホ



建設業・土木業



物流業



小売業(棚卸)



飲食サービス業



医療・介護業界

MIL-STD-810H(米国国防総省が定める耐久試験)21項目と京セラ 独自試験10項目をクリアした高い堅牢性を実現

MIL-STD-810H 21項目

京セラ 独自試験 10項目

鋼球落下 高さ約1.22mから26方向で落下	衝撃	振動	高温動作(1) 50°C/連続3時間	高温動作(2) 32~49°Cまで3サイクル温度変化	コンクリート落下 落下面にサンドペーパー(＃180)を敷いたコンクリートに高さ約1.8mから製品を26方向で落下	タンブル落下 高さ約1.0mから500回連続落下	
防塵	風雨	雨滴	塩水噴霧	湿度	鋼球落下 約100gの鋼球を1mの高さからディスプレイに落下	L字落下 高さ約1.5mから落下	耐荷重
氷結・結露	氷結・低温雨	浸漬	低温動作	低温保管	高温動作 60°C/連続3時間	高温保管(1) 70°C/連続4時間	高温保管(2) 30~70°Cまで変化
高温保管(1) 60°C/連続4時間	高温保管(2) 30~60°Cまで変化	温度耐久・温度衝撃	太陽光照射	低圧動作	低圧保管	泡ハンドソープ洗淨	耐薬品

<MIL-STD-810Hについて>米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810H)の21項目に準拠した試験
 ①Shock(落下)高さ約1.22mから26方向で鋼板に落下させる試験 ②Shock(衝撃)衝撃試験機に端末を取り付け、40Gの衝撃を6方向から3回与える試験 ③Vibration(振動)3時間(3方向各1時間/20~2,000Hz)の振動試験 ④High Temperature(高温動作):50°Cに固定した3時間の動作試験 ⑤High Temperature(高温動作):32°C~49°Cまで3サイクル温度変化させる動作試験 ⑥Sand and Dust(粉塵)連続6時間(風速8.9m/s、濃度10.6g/m³)の粉塵試験 ⑦Blowing Rain(風雨)降雨量1.7mm/min、6方向各30分間の降雨試験、風速18m/s環境下で30分間の降雨試験 ⑧Rain Drip(雨滴)高さ1m雨滴(15分)の防水試験 ⑨Salt Fog(塩水噴霧):連続24時間の5%塩水噴霧後、24時間乾燥させる塩水耐久試験 ⑩Humidity(湿度)連続10日間(95%RH)の高湿度試験 ⑪Freeze-Thaw(氷結・結露):-10°Cで結露や霧を発生させ1時間維持し、25°C、95%RHで動作を確認する試験 ⑫Icing/Freezing Rain(氷結・低温雨):-10°C環境下で着氷した氷の厚さが6mmになるまで氷結させる試験 ⑬Immersion(浸漬):約1.5mの水中に30分間浸漬する試験 ⑭Low Temperature(低温動作):-21°Cに固定した3時間の低温動作試験 ⑮Low Temperature(低温保管):-30°Cで連続4時間の低温保管試験 ⑯High Temperature(高温保管):60°Cで連続4時間の高温耐久試験 ⑰High Temperature(高温保管):30°C~60°Cまでの温度変化させる高温保管試験 ⑱Temperature Shock(温度耐久・温度衝撃):-21°C~50°Cの急激な温度変化において連続3時間の温度耐久試験 ⑲Solar Radiation(太陽光照射)連続20時間1,120W/m²の日射後、4時間offを10日間繰り返す試験 ⑳Low Pressure(低圧動作):連続2時間(57.2kPa/高度約4,572m相当)の低圧動作試験 ㉑Low Pressure(低圧保管):連続2時間(57.2kPa/高度約4,572m相当)の低圧保管試験を実施。

<京セラ 独自試験について>■耐衝撃:落下面にサンドペーパー(＃180)を敷いたコンクリートに高さ約1.8mから製品を26方向で落下させる試験、高さ約1.0mから500回連続落下させるタンブル試験、ディスプレイ面(中央)に約100gの鋼球を1mの高さから落下させる試験、高さ約1.5mからL字型鉄アングルに製品を落下させる試験を実施。すべての衝撃に対して保証するものではありません。
 ■耐荷重:ボディ全体に約100kgfの面荷重を均等にかける試験。■温度耐久:高温動作環境60°Cで連続3時間の動作試験、高温保管環境70°Cで連続4時間の高温耐久試験(1)、30~70°Cまで変化させる高温耐久試験(2)をそれぞれ実施。■泡ハンドソープ洗淨:泡ハンドソープ・泡ボディソープでの手洗い、すすぎの洗淨サイクル試験を実施。■耐薬品:消毒用として市販されているイソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムを少量含ませた柔らかい布での拭き取り試験を実施。

<防水・防塵について>IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。IPX8とは、常温水道水、かつ静水の水深約1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。IP6Xとは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が内部に入らないように保護されていることを意味します。

※本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

【別売】オプション/アクセサリ

【付属品】

ソフトバンク取扱オプション				京セラ 取扱アクセサリ	ACアダプタ (KYCAV1)
電池パック (KYBFN1)	DuraForce EX 電池カバー (KYTFN1)	電池パック 単体充電台 (KYKFN1)	卓上ホルダー (KYEFN1)	ディスプレイ保護フィルム (DFS703)	
					

【主な仕様】 ソフトバンク販売モデル DuraForce EX(デュラフォースイーエックス)

ディスプレイ	約5.8インチHD+ TFT液晶 (HYBRID SHIELD®搭載)	Wi-Fi®	IEEE802.11a/b/g/n (2.4/5GHz) /ac
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約77×163×14.9mm		IEEE802.11r [*] /k ^{**} /v ^{**} /w (Wi-Fi高速ローミング)
重量	約248g		※部分的対応
バッテリー容量	4,270mAh	衛星測位システム	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS対応
OS	Android™ 13/14	Bluetooth®	Ver.5.3
CPU	MediaTek Dimensity® 700 2.2GHz(2コア)+2.0GHz(6コア)	外部接続	USB Type-C™ /イヤホンジャック (3.5φ)
カメラ	メイン (アウト)	耐衝撃/防水/防塵	耐衝撃 (MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IV) / 防水 (IPX5/IPX8) / 防塵 (IP6X)
	サブ (イン)		
メモリ	内蔵	NFC/FeliCa®	○ / ○ (おサイフケータイ® 対応)
	外部	microSDXC™(最大1TB)	○
対応SIM	Dual SIM (nano SIM+eSIM)	sXGP ^{*3}	○
対応通信規格 ^{*1}	LTE™: 1/3/8/18/19/28/39/41/42	生体認証	顔認証 (Class2) / 指紋認証 (Class3)
	5G: 1/3/28/77/78/79	付属品	ACアダプタ

*1: 5G通信は対応エリアで使用可能です。*2: 別途、3.5φジャックの有線イヤホン(別売)のご用意が必要です。*3: sXGPをご利用の場合、別途、専用SIMが必要です。

※「DURA FORCE」、「HYBRID SHIELD」、「ハイブリッドシールド」、「グローブタッチ」、「ウェットタッチ」、「JAPAN MADE (ロゴ)」は、京セラ株式会社の登録商標です。※LTEは、ETSIの商標です。※Google、Android、Google Play、Chrome、およびその他のマークはGoogle LLCの商標です。※MediaTek、Dimensityは、MediaTek Inc.の商標または登録商標です。※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。※Bluetooth®、ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。※microSD、microSDXCはSD-3C,LLCの商標です。※Dragontrail®はAGC Inc.の登録商標です。※おサイフケータイ®は、株式会社NTTドコモの登録商標です。※📶はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。※FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※本製品は下記URLに掲載されているHEVC特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。patentlist.accessadvance.com

注意 本製品は、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

